

世界理工系トップ大学との学生交流促進プログラム 2011 の追加募集について ～ TASTE (Tokyo Tech Abroad Short-Term Education) 海外短期学習 ～

東京工業大学・国際室では、本学が授業料等不徴収協定を締結している大学へ1学期以上1年以内の間、留学する派遣交換留学プログラムを中心として多数実施しており、毎年50～60名の学生を海外の協定大学へ派遣しています。

このたび、将来に向けて長期の留学や研究活動を予定している本学の学生を対象に各協定大学で実施する短期間(60日以内)の留学プログラム等へ参加する者又は各協定大学において研究活動を行う者に対して経済支援を行うことになりましたので、お知らせします。

この「世界理工系トップ大学との学生交流促進プログラム」は、本学の学生が海外の大学において短期留学における学習経験を活かして、より充実した長期の留学や将来的に海外での研究活動等が実現できるように支援を行うことを目的とするものです。

なお、対象となる短期留学プログラムは個人応募のものとし、各機関へ 直接 参加者が応募するものに限りません。

記

1. 対象者:

- 応募時点で、本学の正規課程に在籍する者(国費留学生・私費留学生ともに応募可)
- 2011年度以降、本学の派遣交換留学等にて留学を希望する者
- 留学期間終了後、本学に戻り学業を継続する者、または本学の学位を取得する者
- **成績評価係数 2.0 以上(前年度成績)、かつ TOEIC500 点以上**またはそれと同等の英語能力を保有する者

* ただし、応募書類一式を日本語で作成すること

* 留学生の場合は、自国への留学は不可

* 成績評価係数の算出方法は以下のとおり

前年度の成績を3段階(80～100点=3.0, 70～79点=2.0, 60～69点=1.0)で換算した後に、
総登録単位数の評価平均値を算出するものです。

$$\frac{(\text{評価ポイント } 3.0 \text{ の単位数} \times 3) + (\text{評価ポイント } 2.0 \text{ の単位数} \times 2) + (\text{評価ポイント } 1.0 \text{ の単位数} \times 1)}{\text{総登録単位数}} = \text{成績評価係数}$$

総登録単位数

2. 支援対象時期:

平成23年10月1日～平成24年2月29日までに活動を開始し、平成24年3月31日までに終了するもの
(当該活動の期間前後7日間以内に渡航し・帰国を完了していなければならない。)

3. 対象となる活動

- 下記、派遣先大学一覧にある各協定大学で実施される短期留学プログラム(60日以内)へ参加するもの
ショートプログラム、語学研修プログラム等の語学力や国際コミュニケーション能力の向上、または専門性を高める内容であること
- 下記、派遣先大学一覧にある各協定大学において短期間の研究活動(60日以内)を行うもの
※プログラム実施の前後に旅行等をつなげて留学することは不可。移動日は対象期間に含まない

派遣先大学一覧:

- ① 韓国科学技術院(Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)/韓国)
- ② 清華大学(Tsinghua University /中国)
- ③ 香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology/中国)
- ④ シンガポール国立大学(National University of Singapore(NUS)/シンガポール)
- ⑤ 南洋理工大學(Nanyang Technological University/シンガポール)
- ⑥ インペリアルカレッジロンドン(Imperial College London/英国)
- ⑦ スイス連邦工科大学チューリッヒ校(Swiss Federal Institute of Technology Zurich(ETH Zurich)
/スイス)
- ⑧ アーヘン工科大学(Aachen University(RWTH)/ドイツ)
- ⑨ デルフト工科大学(Delft University of Technology(TU Delft)/オランダ)
- ⑩ パリ・テック(Paris Institute of Technology(ParisTech)/フランス)
- ⑪ マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology(MIT)/米国)
- ⑫ ジョージア工科大学(Georgia Institute of Technology(Georgia Tech)/米国)
- ⑬ ワシントン大学(University of Washington(UW)/米国)
- ⑭ ポーハン科学技術大学(Pohang University of Science and Technology(POSTEC)/韓国)
- ⑮ ソウル国立大学(Seoul National University/韓国)
- ⑯ スウェーデン王立工科大学(Royal Institute of Technology(KTH)/スウェーデン)
- ⑰ シャルマーズ工科大学(Chalmers University of Technology/スウェーデン)
- ⑱ ミュンヘン工科大学(Technische Universität München/ドイツ)
- ⑲ シュツツガルト大学(Universität Stuttgart/ドイツ)
- ⑳ ボローニャ大学(University of Bologna/イタリア)
- ㉑ ウィーン工科大学(Vienna University of Technology/オーストリア)
- ㉒ スイス連邦工科大学ローザンヌ校(Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
(ETH Lausanne) /スイス)
- ㉓ ジュネーブ大学(University of Geneva/スイス)

4. 支援内容:

奨学金: 活動の期間により支援金額が異なる

8万円(10日~31日以内)

16万円(32日以上~60日以内)

備考: 助成が決定した者については、以下の事項に対し留意すること

*奨学金の支給が渡航後になる可能性があること。

*指定する期日までに、自費で航空券を購入し、ビザ取得等を含む全ての渡航手続きを完了すること。

*帰国後、パスポートの入出国スタンプ(該当箇所の写真)、終了報告書、語学試験(TOEFL/TOEIC等)を受験し、そのスコア(原本写し)を提出すること。

5. 募集人数: 6名程度

6. 応募書類: ※書類不備、日本語以外で作成した応募書類は受付不可

- 1) 申請書(国際室ホームページからダウンロード可能)
http://www.ipo.titech.ac.jp/exchange/program/program_vs.html
- 2) 既存のプログラムに参加の場合にはプログラムの内容を、研究活動を行う場合には研究活動の内容を具体的に説明できる書類(応募学生本人作成のもの・書式自由)
※プログラム参加の場合には参加プログラムの HP、パンフレットの写し等を添付すること
- 3) プログラム参加の場合にはプログラム参加の申し込み・参加決定が分かる書類
研究活動を行う場合には受入先の教員とのメールのやり取り等連絡状況が分かる書類
(派遣先大学やプログラムを主催する事務局又は受入れ教員等との連絡状況など)
- 4) ビザの有無・申請状況が分かる書類(大使館の HP 等)
- 5) 渡航先の安全管理についての関連情報(外務省の海外安全 HP 等)
- 6) 語学試験の成績証明書(原本)の写し(TOEIC スコアシート等)
- 7) 成績証明書(学部生:学部の成績証明書(コピー可)、大学院生:学部及び大学院の成績証明書(コピー可))

7. 選考方法:

応募者から提出された申請書に基づき、書類審査を行う

8. 書類締切:

各月の末日(平成 23 年 9 月～平成 24 年 1 月までの間) 17 時厳守 (下記書類提出先に持参してください。)

※但し、遅くとも派遣開始 1ヶ月前までには提出すること

※但し、上記最終〆切までに募集人数に達した場合には、その時点で募集を終了する

9. 問い合わせ・書類提出先:

国際部留学生交流課 派遣担当 吉原・小林 (本館 1 階 121 号室)

(電話: 03-5734-7645 Email: hakenryugaku@jim.titech.ac.jp)

■ 応募対象となるプログラム (例) は国際室 HP を参照:

http://www.ipo.titech.ac.jp/exchange/program/program_o.html

<プログラム> → その他 → “個人応募の海外留学プログラム(各機関へ直接応募するもの)”

※の印があるプログラムは本奨学金応募対象となる派遣先大学の留学プログラム

なお、派遣先大学が授業料等不徴収協定校であっても、各プログラム参加や研究活動を行う際に派遣先大学に対して授業料等の支払いが必要となる場合には、授業料・参加料等は免除されないので、留意すること。